****

|  |  |
| --- | --- |
| **Contact pour les lecteurs :** | **Contact pour la presse :** |
| **congatec SAS.** | **SAMS Network**  |
| Luc Beugin | Michael Hennen |
| Téléphone : +33 6 44 32 70 88 | Téléphone : +49-2405-4526720 |
| info@congatec.com[www.congatec.com](http://www.congatec.com/) | info@sams-network.com [www.sams-network.com](http://www.sams-network.com) |



*Texte et photo disponibles:* [*https://www.congatec.com/fr/congatec/communiques-de-presse.html*](https://www.congatec.com/fr/congatec/communiques-de-presse.html)

**Communiqué de presse**

congatec présente la 8e génération de processeurs Intel® Core Mobile
sur formats embarqués

**Processeurs BGA sur cartes embarquées
de haute qualité**

* Ouvre de nouvelles applications
* Prend en charge les stratégies du “premier sur le marché”

**Deggendorf/Nuremberg, Allemagne, 26 février 2019** \* \* \* congatec - acteur de premier plan dans le domaine des cartes et modules informatiques embarqués personnalisés -, présente ses premiers formats embarqués avec les tout nouveaux processeurs Intel® Core™ Mobile processors 8e génération (nom de code Whiskey Lake) à l’Embedded World 2019. Ce lancement de modules COM Express Type 6 Compact, SBC 3,5 pouces et cartes-mères Thin Mini-ITX, tous équipés de processeurs Intel Core i7-9565U Mobile du commerce, permet à congatec de jouer un rôle de pionnier dans le lancement de cette nouvelle génération de processeurs pour environnements hostiles et espaces restreints. Les clients OEM ont un accès précoce à la nouvelle technologie de processeur haut de gamme et bénéficie des stratégies du premier sur le marché. Les clients finaux industriels bénéficient d’une augmentation des performances applicatives instantanée jusqu’à 40% par rapport aux précédents processeurs U-Series, grâce à 4 cœurs au lieu de 2 plus une microarchitecture globalement améliorée.

“L’un de nos principaux objectifs est de simplifier l’utilisation de la technologie informatique embarquée autant que possible pour nos clients. C’est la raison pour laquelle nous proposons nos Computer-on-Modules embarqués, SBC 3,5 pouces, cartes-mères Mini-ITX désormais également disponibles sous des variantes BGA standards avec les processeurs Intel Core 8e Génération. Cela aide les OEM qui veulent déployer les dernières technologies processeur aussi rapidement que possible, notamment au niveau mobile hautes performances où les cycles de vie sont plus courts, et où les OEM sont à la recherche de plates-formes informatiques embarquées complémentaires, pour réaliser par exemple la fabrication de boucles fermées avec les meilleures classes de performances. Nos nouvelles cartes embarquées sont prévues exactement pour cela”, explique Christian Eder, Directeur du Marketing chez congatec.

Les nouveaux processeurs sont essentiellement la principale source pour développer des variantes embarquées des nouvelles générations de microarchitecture. Ils arrivent sur le marché plus tôt que les variantes embarquées. Par rapport aux variantes embarquées, les processeurs standards manquent principalement d’un support à long terme, ce qui n’est pas toujours la priorité n°1 dans la course aux hautes performances embarquées. Les clients OEM qui sont satisfaits de cela mais ont besoin d’un format embarqué robuste sont donc parfaitement servis avec ces SBC 3,5 pouces hybrides embarquées, cartes-mères Thin Mini-ITX et modules COM Express Type 6, car ces produits combinent les avantages des processeurs standards avec ceux des cartes et modules embarqués robustes. Même les fournisseurs qui veulent utiliser les variantes embarquées dans des productions en série bénéficient de ces cartes car grâce aux API identiques fournies par les fournisseurs de cartes embarquées, ils peuvent tester leurs applications sur des plates-formes appropriées bien plus tôt qu’avant.

**Jeu de fonctions en détail**

Les nouvelles SBC conga-JC370 hybrides embarquées 3,5 pouces, cartes-mères conga-IC370 Thin Mini-ITX et modules conga-TC370 COM Express Type 6 sont tous équipés du processeur Intel Core i7-9565U Mobile quad-core 1,8GHz qui impressionne avec une augmentation des performances de 40% par rapport aux processeurs U-Series précédents qui a été possible par un bond de 2 à 4 cœurs avec l’amélioration de la micro-architecture. La mémoire est conçue pour correspondre à ce gain en performances : deux sockets SODIMM DDR4 avec jusqu’à 2400 MT/s sont disponibles pour un total de 64 Go. Pour la première fois, l’USB 3.1 Gen2 est maintenant prise en charge en natif. Cette interface USB SuperSpeed+ est capable de transférer jusqu’à 10 Gbps ou 1,25 Go/s, ce qui rend possible le transfert de vidéos UHD même non compressées d’une caméra vers un écran. La nouvelle SBC 3,5 pouces fournit cette performance via un connecteur USB-C à l’arrière qui prend aussi en charge 1 DisplayPort++ et la fourniture d’alimentation pour les appareils périphériques, Assurant donc la connexion d’un écran avec un seul câble pour la vidéo, l’écran tactile et l’alimentation. Les modules COM Express prennent en charge les mêmes fonctions sur les cartes porteuses. D’autres interfaces dépendent du format mais toutes prennent en charge 3 écrans UHD 60 Hz indépendants avec jusqu’à 4096 x 2304 pixels ainsi que 2 x Gigabit Ethernet (1x avec support TSN). Les nouvelles cartes et modules proposent tout cela et beaucoup d’autres interfaces avec un TDP économique de 15 W, qui peut s’échelonner de 10 W (800 MHz) à 25 W (jusqu’à 4,6 GHz en mode Turbo Boost).

Plus d’informations sur la nouvelle SBC conga-JC370 3,5 pouces sur :

<https://www.congatec.com/fr/produits/35/conga-jc370.html>

Plus d’informations sur la nouvelle carte-mère conga-IC370 Thin Mini-ITX sur : <https://www.congatec.com/en/products/mini-itx-single-board-computer/conga-ic370.html>

Plus d’informations sur le nouveau Computer-on-Module conga-TC370 COM Express Type 6 sur : <https://www.congatec.com/fr/produits/com-express-type-6/conga-tc370.html>

**A propos de congatec**

congatec est un fournisseur de premier plan de modules informatiques utilisant les standards COM Express, Qseven et SMARC ainsi que de cartes SBC (Single Board Computers) et de services de personnalisation (cartes custom). Les produits congatec peuvent entrer dans un grand nombre d'industries et d'applications comme l'automatisation industrielle, les équipements médicaux, les loisirs, les transports, les télécoms, les tests et mesure et les points de vente. Parmi les compétences et le savoir-faire technique de congatec, citons des fonctions BIOS uniques, des pilotes et des BSP (Board Support Packages) complets. Après la phase de design, les clients bénéficient d'un support tout au long du cycle de vie du produit. Les produits congatec sont fabriqués par des grands noms du monde de la sous-traitance électronique en respectant les standards de qualité. Avec son siège social basé à Deggendorf, Allemagne, congatec possède des filiales aux Etats-Unis, Taiwan, Chine, Japon et Australie ainsi qu‘en Grande-Bretagne, France et République Tchèque. Site web : [www.congatec.com](http://www.congatec.com) ou via [Facebook](http://www.facebook.com/Congatec), [Twitter](https://mobile.twitter.com/congatecAG) et [YouTube](http://www.youtube.com/congatecAE)

\* \* \*

*Intel et Intel Core sont des marques enregistrées d’Intel Corporation aux Etats-Unis et dans d’autres pays.*